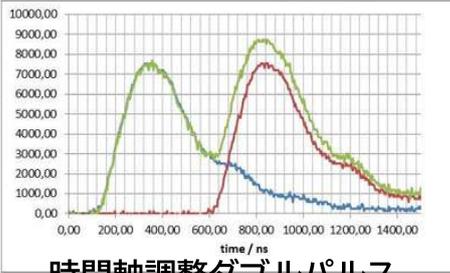
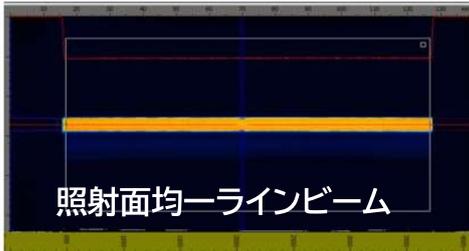


# 高スループットSiCレーザーアニーリングエンジン (オーミックコンタクト形成)

レーザー発振器



時間軸調整ダブルパルス

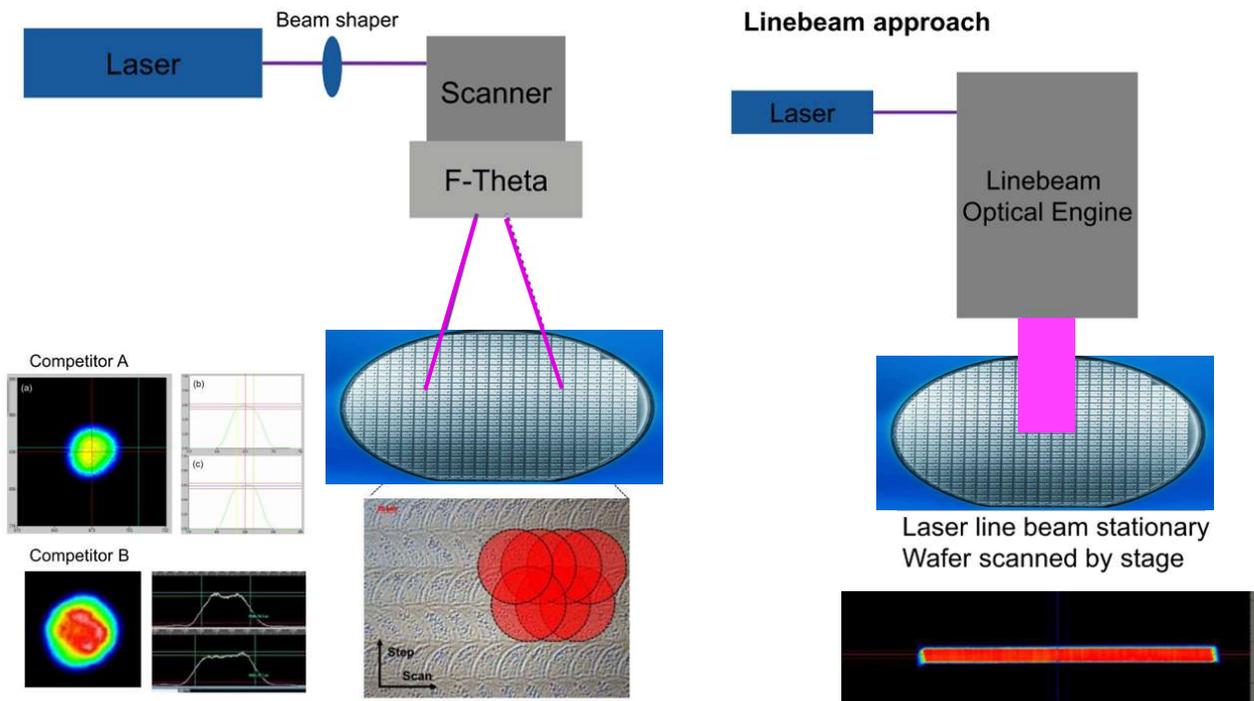


照射面均一ラインビーム



SiCアニーリング OCF-80	
ウェハーサイズ	100/150/200mm
レーザー	355nm 80W 10kHz
レーザーラインサイズ	3mm x 30 $\mu$ m トップハット
プロセス時間	60-300ns (パルスディレイコントロール)
エネルギー密度	5J/cm <sup>2</sup> (可変)
スループット	>30WPH

## 従来方式のスループット3倍



従来方式  
ガルバノスキャナー光学系  
ガウシアンビーム  
不均一熱処理



ラインビーム方式  
ステージスキャン  
均一ラインビーム  
均一熱処理